



钢泰公司

From One Engineer to Another®



**“我们相信
材料科学改变世界。”**



几乎所有的重要科技进步都可以说是由材料科学的重大突破而开始的。自1934年创立以来，钢泰公司一直以“化腐朽为神奇”的精神来引领材料创新。

Ross Berntson
总裁兼首席运营官



我们的目标——您的成功

通过提供基于先进材料的优质设计、应用和服务，提高我们客户的生产力和利润。

我们成功的基石

- 卓越的产品质量和性能
- 专业的技术和客户服务
- 尖端材料的研发
- 覆盖广泛的产品线
- 最低的总体成本



研发实验室

- **先进材料和工艺开发实验室：**
全方位解析前沿技术应用的材料和工艺
- **热导实验室：**
通过分析导热材料的热阻和热导等特性来帮助确定最佳应用
- **研发实验室：**
推进材料科学发展从而创造独特的新产品
- **科技中心：**
为高效研发提供电子组装专业知识和服务



行为守则



钢泰公司对客户、同事、组织和我们自己的专业承诺包括明确的**行为守则**

。守则包括如下内容：

- 道德规范
- 员工管理
- 健康安全
- 环境保护
- 管理系统

我们还通过各种活动包括志愿服务、活动赞助和顾问咨询等参与当地社区建设。



始于1863...

锡金属于1863年被发现，Ferdinand Reich 和 Hieronymus Theodor Richter 为发现人。之后的很多年，这种神奇资源的性质和能力都处于未知状态，直到William S. Murray 博士于1942年在纽约州Utica开始研究锡的物理和化学特性。



锡泰公司研制出商业上可行的精密预成型焊片制造工序，促使合金结型晶体管的规模化生产成为可能。



锡泰公司研发并推出了 InFORMS® 预成型焊片。此产品控制焊接层厚度保持一致，从而解决了基板倾斜问题，可靠性翻倍。

锡泰公司为半导体产业开发出了世界第一款免洗倒装焊助焊剂——“Power-Safe” NC-SMQ75。此产品有印刷用和点胶用版本。



1863

1934

1952

1977

1991

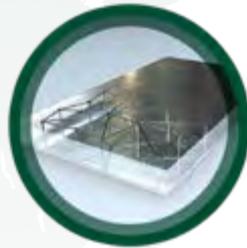
2014

2019

锡泰公司（原美国锡公司）在美国纽约州 Utica 805 Watson Place 创立。总裁 William S. Murray, 副总裁 J. Robert Dyer, Jr., Daniel Gray 出任技术总监。



锡泰公司开始了对焊锡膏的研发。——这是锡泰公司在开发高可靠性焊锡膏路上所迈出的第一步。锡泰公司焊锡膏旨在解决行业挑战、满足最新的法律法规规定并提供超越行业测试标准的高品质产品。



锡泰公司为所有焊锡膏工厂以及公司总部获得了 ISO/IATF 16949 管理系统认证。当中包括美国纽约州 Clinton 和 Utica、新加坡、英国 Milton Keynes 和中国的工厂。这再次证明和保证了锡泰公司用最高标准规范生产过程，保证客户最终产品的可靠性。

服务行业



汽车



国防



移动设备



功率器件



通信



激光/光纤



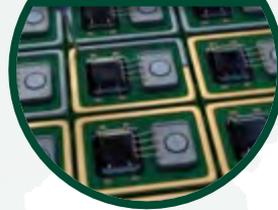
LED



医疗



MEMS



金属提炼/回收



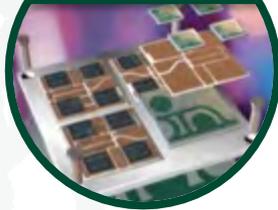
PCBA



RF/微波



热管理



钻井



我们的质保承诺

- 提供满足甚至超越客户需求的**高品质产品**
- 创造专注于满足客户需求和持续提升自我的**公司文化**
- 生产**符合法律法规的产品**
- 关注**缺陷预防**
- 及时处理**内部及外部客户的意见**
- 识别并提供**必要的资源**



Mike McNamara
Corporate Quality Director



IATF 16949 证书

Clinton,美国纽约州

Utica, 美国纽约州

新加坡

Milton Keynes, 英国

中国苏州



质量认证

- IATF 16949
- ISO 14001:2004
- ISO 9001:2008
- REACH
- RoHS
- IMDS

公司政策

- International Traffic in Arms Regulations (ITAR)
- California Transparency in Supply Chains Act
- System for Award Management (SAM)
- Metal Supply Chain Policy
- Corporate Quality Policy
- Corporate Safety Policy
- Environmental Policy





**85年
稳健增长**

**900+员工
13处设址**

**世界一流的技
术和管理：从
设计到生产**

Chicago



Clinton
Utica
Rome

Milton
Keynes

Torino

Shenzhen

Suzhou

Cheongju

Malaysia

Singapore



Greg Evans
首席执行官

我们的企业文化——**钢泰之道**
支持着我们在通过材料科学改
变世界的道路上继续前行。

The Indium Way.
respect. appreciation. achievement.



先进 电子组装材料

钢泰公司提供:

- 焊锡膏
- 预成型焊片
- 金属导热界面材料 (mTIMs)
- 波峰焊助焊剂
- 叠层封装 (PoP) 助焊剂和焊锡膏
- 含 (助焊剂) 芯焊锡线
- 助焊膏
- 焊锡块
- 高分子底部填充剂
- 其他



www.indium.com/solders



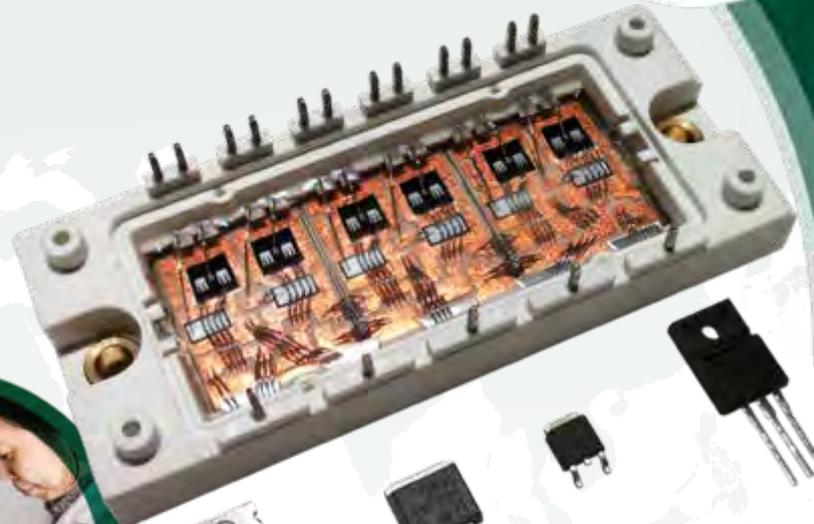
前沿

半导体和高级封装材料

镭泰的材料确保了产品的坚固和可靠，使其得以应对物联网 (IoT) 移动设备、下一代低功耗服务器和汽车电子应用中无法避免的物理冲击和热应力等。

我们供应:

- 焊锡膏
- 助焊剂
- 焊锡线
- 焊锡球



www.indium.com/SAAM

精密 工程焊料

我们的制造工程师为迎合市场对小零件、替代材料、优化的包装及量产的原型的需求研发了相应的设备和工艺。

我们为如下需求提供解决方案：

- 键合、焊接和硬钎焊
- 热管理
- 对先进材料的要求
- 机械要求（如热膨胀系数不匹配）
- 自动装配的适配包装

www.indium.com/preforms

领先

导热界面材料

钢泰公司组建了热导实验室，从而保证我们的工程师能评估客户的产品设计、模拟其工作环境、测量性能并提供相应的解决方案。

我们的研究创造了重要的热管理产品，包括：

- 导热预成型焊片
- Heat-Spring®
- 液态金属合金
- InFORMS®
- NanoFoil®



www.indium.com/TIMs

引领

金属及化合物

钢泰公司是世界领先的供应商：

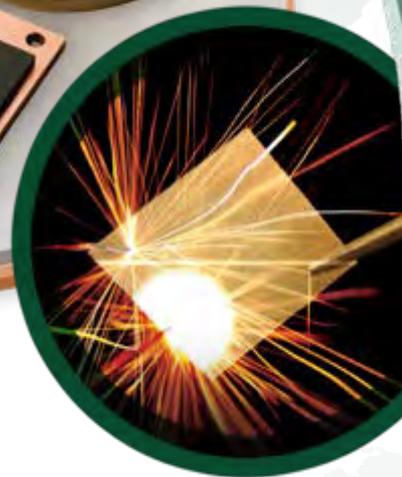
- 商业级和超纯金属铟
- 所有的铟化合物
- 锗的金属及化合物
- 镓的金属及化合物
- 锡的金属及化合物
- 回收服务



www.indium.com/metals
www.indium.com/compounds

革新 纳米科技

NanoFoil® 是像纸一样薄的金属箔片 — 它由一千多层纳米级的反应式金属层组成。当NanoFoil®被激活时，它能在千分之一秒内自发在箔片区产生高热。这种精密程度，使得我们可以准确地控制热能的时间、位置和时长。



www.indium.com/nanofoil

全线产品满足组装的方方面面

- 先进电子组装材料
 - 焊锡膏、助焊剂、预成型焊片、焊锡线等
- 工程焊料和导热界面材料
 - 热管理、组装自动化、焊接、硬钎焊等的解决方案
- 半导体和高级封装材料
 - 为异构集成技术的各个阶段提供材料
- 金属及化合物
 - 全线商业级和超纯金属
 - 回收业务
- 先进的纳米技术
 - 多种高科技纳米产品和技术，包括 NanoFoil® 和 NanoBond®





china@indium.com
www.indium.com
www.indiumchina.com